(19) 日本國特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-288259

(43)公開日 平成7年(1995)10月31日

(51) Înt.Ĉl.º		識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
Hồ Í L	21/363		8719-4M				
C03B	23/02						
C 3 0 B	29/48		8216-4G				
H01L	21/203	М	8719-4M				
	33/00	D					
					 	(A = TET)	PH 45 TEX 1 44 2

審査請求 未請求 請求項の数2 FD (全 5 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号

特願平6-102295

(22)出顧日

平成6年(1994)4月15日

(71)出願人 000006655

新日本製織株式会社

東京都千代田区大手町2丁目6番3号

(72)発明者 藤井 智

相模原市獨野辺 5-10-1 新日本製鐵株

式会社エレクトロニクス研究所内

(72)発明者 寺田 敏行

相模原市潤野辺 5-10-1 新日本製鐵株

式会社エレクトロニクス研究所内

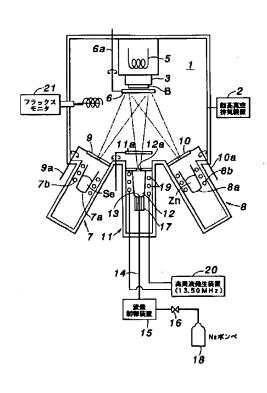
(74)代理人 弁理士 大島 陽一

(54) 【発明の名称】 分子線エピタキシー装置

(57)【要約】

【目的】 窒素ドーピングガスの励起が容易であり、か つ結晶成長条件に影響を及ぼすことがなく、基板上に高 い品質のII-VI族化合物半導体エピタキシャル結晶 を成長させることができる構造の簡単な分子線エピタキ シー装置を提供する。

【構成】 結晶成長室側に開口すると共に窒素ガスの供 給口を具備する有底筒状のケーシングの底部に磁石が設 けられ、更にケーシングの外周に高周波コイルを配設し たプラズマセルからなる励起セル装置を用いて窒素ドー パントを供給することで、低圧状態でも低い高周波パワ ーで高いプラズマ放電発光強度が得られることから、容 易にドーパントガスを励起できると共にドーピングに寄 与しない窒素分子ビーム量が減り、更に放電室内壁など からの汚染物質の発生が抑制される。また、プラズマを 発生させる際の結晶成長室内の圧力変動が殆どなくなり 成長原料の分子ビームが安定する。



1

【特許請求の範囲】

基板の表面に、II族元素及びVI族 【請求項1】 元素からなる成長原料と窒素ドーパントガスとを供給す ることによりII-VI族化合物半導体エピタキシャル 結晶を成長させる分子線エピタキシー装置であって、 前記窒素ドーパントを供給する励起セル装置が、結晶成 長室側に開口すると共に窒素ガスの供給口を具備する有 底筒状のケーシングと、該ケーシングの底部に設けられ た磁石と、前記ケーシングの外周に配設された高周波コ イルとを有するプラズマ励起セルからなることを特徴と する分子線エピタキシー装置。

前記II族元素が亜鉛(Zn)からな 【請求項2】 り、前記VI族元素がセレン(Se)からなることを特 徴とする請求項1に記載の分子線エピタキシー装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、基板の表面に「「族及 びVI族の成長原料及び窒素ドーパントガスを供給する ことによりII-VI族化合物半導体エピタキシャル結 晶を成長させる分子線エピタキシー装置に関し、特に上 20 記ガスを励起させるための励起セル装置に特徴を有する 分子線エピタキシー装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】化合物半導体のエピタキシャル結晶成長 には主として分子線エピタキシー法(以下、本明細書で はMBE法と略記する)や有機金属化学気相成長法など が一般的に用いられている。

【0003】一方、特開昭62-88329号公報には II-VI族のエピタキシャル結晶の一例として砒化ガ リウム (GaAs) 基板上へのセレン化亜鉛(ZnS e)のエピタキシャル結晶を成長させ、ドーパントとし て砒素(As)、リン(P)、または窒素(N)を導入 してp型結晶を得るための構造が開示されている。ま た、米国のDePuydtらによれば、MBE法にてr fプラズマ励起セルにより活性窒素ビームを発生させ、 1018cm-3台の窒素ドーピングを実現する方法が提案 されており (Appl. Phys. Lett. 57, 2127 (1991) 参照)、こ れにより低抵抗のp型結晶が得られることが示唆されて

【0004】しかしながら、rfプラズマ励起セルによ り活性窒素ビームを発生させるには、気圧条件を少なく とも10-5~10-6 torr程度にしなければならない が、MBE法の一般的な適用条件が10-7~10-10 t orr程度であることから、条件が一致せず、例えば多 い窒素流量や高い高周波パワー(300W~500W) を必要とし、ドーピングに寄与しない窒素分子ビーム量 が増えたり、セル周辺が加熱されて放電室内壁などから の汚染物質が発生するばかりでなく、プラズマ発生時の 圧力変動によりクヌーセンセルから発生する成長原料の 分子ビームに揺らぎなどを生じるため、これらの理由か 50 マ励起セルとで高周波パワーに対するプラズマ放電発光

ら結晶の品質が低下する問題があり、実際にはあまり現 実的ではなかった。

【0005】一方、ECRプラズマ放電やマイクロ波放 電を用いて窒素ラジカルビームを発生させる方法も提案 されているが (ECRプラズマ放電:例えばS.Itoh et al., Jpn. J. Appl. Phys. 31, L1361 (1992) 参照、マイクロ波 放電:例えば塚他第40回応用物理学関係連合講演会 3 1p-ZN1参照)、rfプラズマ励起セルよりもやや低い気 圧(10-7torr台後半程度)で放電を維持できるも のの、上記結晶の品質低下、分子線の揺らぎなどの問題 を完全に解決することはできず、またrfプラズマ励起 セル程の高濃度ドーピングが困難であり、更に装置が複 雑、かつ高価であることからメンテナンス性やコスト面 で問題がある。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明は上述したよう な従来技術の問題点に鑑みなされたものであり、その主 な目的は、窒素ドーピングガスの励起が容易であり、か つ結晶成長条件に影響を及ぼすことがなく、基板上に高 い品質のII-VI族化合物半導体エピタキシャル結晶 を成長させることができ、更に構造の簡単な分子線エピ タキシー装置を提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】上述した目的は本発明に よれば、基板の表面に、II族元素及びVI族元素から なる成長原料と窒素ドーパントガスとを供給することに よりII-VI族化合物半導体エピタキシャル結晶を成 長させる分子線エピタキシー装置であって、前記窒素ド ーパントを供給する励起セル装置が、結晶成長室側に開 30 口すると共に窒素ガスの供給口を具備する有底筒状のケ ーシングと、該ケーシングの底部に設けられた磁石と、 前記ケーシングの外周に配設された高周波コイルとを有 するプラズマ励起セル(以下、本明細書ではヘリコンプ ラズマ励起セルと記す)からなることを特徴とする分子 線エピタキシー装置を提供することにより達成される。

[0008]

【作用】上述の構成によれば、ヘリコンプラズマ励起セ ルにより低圧 (10⁻⁷~10⁻⁹torr程度) の状態で あっても低い高周波パワー (5W~300W)でrfプ **ラズマ励起セルよりも1桁程度高いプラズマ放電発光強** 度が得られることから、プラズマを発生させる際の結晶 成長室内の圧力変動が殆どなく、クヌーセンセルから出 射される成長原料 (Zn、Se) の分子ビームが安定す る。また、ドーピングに寄与しない窒素分子ビーム量が 減り、成長面でのマイグレーションが促進され、更にセ ル周辺の加熱が抑制されて放電室内壁などからの汚染物 質の発生が抑制される。図3に、窒素ガス流量を0.1 cc/min、スペクトル位置763nmとして他の条 件を同じにしたヘリコンプラズマ励起セルとrfプラズ 強度を比較したグラフを示す。

[0009]

【実施例】以下、添付の図面に従って本発明の好適実施 例について説明する。

【0010】図1は本発明が適用された分子線エピタキシー装置(MBE装置)の概略構成を示す模式的断面図である。本実施例は砒化ガリウム(GaAs)基板上へのセレン化亜鉛(ZnSe)のエピタキシャル結晶を成長させ、ドーパントとして窒素(N)を導入してp型結晶を得るためのMBE装置である。

【0011】超高真空排気装置2により10-7~10-9 torr程度の高真空を維持可能な結晶成長室1内には ホルダ3により処理表面が下向きになるように基板Bが 保持されている。このホルダ3の基端側、即ち図に於ける上側には基板加熱用のヒータ5が設けられている。また、円板状のメインシャッタ6が、基板Bの成膜を開始 する位置、即ち基板Bの処理表面を覆わない位置と、成 膜を停止する位置、即ち基板Bの処理表面を覆う位置と の間で回動自在に支持され、その駆動軸6aを外部から 回転させることにより成膜を選択的に開始/停止し得る ようになっている。

【0012】結晶成長室1の下部に於ける基板Bと概ね対向する位置には、基板Bに向けて開口する2つのクヌーセンセル(以下、本明細書ではKセルと略記する)7、8が設けられている。これらKセル7、8は、基板Bに向けて開口するるつぼ7a、8aを加熱するためのヒータ7b、8bとを有している。また、各Kセル7、8の開口部には上記メインシャッタ6と同様な円板状のシャッタ9、10が、各Kセル7、8の開口を覆う位置と、開口を覆わない位置との30間で回動自在に支持され、その駆動軸9a、10aを外部から回転させることにより選択的に各るつば7a、8a内に受容された成長原料を分子ビームとして基板Bに向けて照射するようになっている。

【0013】一方、各Kセル7、8とは別に結晶成長室 1の下部に於ける基板Bと概ね対向する位置に窒素プラ ズマの励起セル装置11が設けられている。図2に良く 示すように、この励起セル装置11は、結晶成長室1側 に開口し、内部にプラズマ発生室を郭成する高純度セラ ミックからなる有底筒状のケーシング12と、該ケーシ 40 ング12の底部に開口し、かつ管路14、流量制御装置 15及び減圧弁16を介して窒素ボンベ18に接続され た窒素ガスの供給口13と、管路14を外囲するように ケーシング12の底部に設けられた筒状の磁石17と、 ケーシング12の外周に配設され、高周波発生装置20 に接続された高周波コイル19とを具備するプラズマ励 起セルからなる。ケーシング12の開口にはこれを絞る オリフィス12aが設けられている。また、ケーシング 12の開口には上記シャッタと同様なシャッタ11aが 設けられている。

【0014】尚、結晶成長室1内の適宜な位置には公知のB-A型電離真空計からなるフラックスモニタ21が設けられ、各分子ビームの強度を測定し得るようになっている。

4

【0015】以下に本実施例の作動要領について説明する。まず、るつば7aにセレン(Se)、るつば8aに 亜鉛(Zn)を受容し、基板Bをホルグ3に下向きに保持して結晶成長室1内を超高真空排気装置2により真空 引きして $10^{-7}\sim10^{-9}$ torr程度の高真空を維持する。そして、基板Bを回転させると共に加熱すると共にセレン、亜鉛を加熱する。このとき、各シャッタ6、9、10、11aはまだ閉じられている。

【0016】次に、所定時間経過後に各シャッタ9、1 0を順番に開閉してフラックスモニタ21をもってセレ ン及び亜鉛の分子ビームが強度1:1で安定したことを 確認する。そして、シャッタ11aを開いて励起セル装 置11にて高周波を発生させ(5W~300W)、窒素 ガスを0.01cc/min~0.5cc/minの範 **囲の流量でケーシング12内に郭成されたプラズマ発生** 室に供給する。ここでは磁石17による磁場と高周波コ イル19との相互作用により高密度の窒素プラズマが発 生する。その後、窒素プラズマが安定したら、シャッタ 9、10、11aを開き、最後にシャッタ6を開いて基 板Bの表面にセレン化亜鉛のエピタキシャル結晶を成長 させつつその中に窒素をドーパントとして導入してp型 結晶を得ることができる。このようにして形成されたp 型結晶では1×1018 c m-3のキャリヤ濃度が得られ た。

【0017】ここで、高周波パワーを5W未満にすると 放電が起こらず、300Wを超えると結晶中に窒素原子 が入り過ぎて結晶の品質が低下する。また、窒素ガス流 量を0.01cc/min未満にすると放電を維持する ことが困難になり、0.5cc/minを超えるとMB E装置の結晶成長に於ける圧力条件から外れる心配が生 じる。

【0018】尚、本実施例に於てフラックスモニタ21を常に監視してその値に応じて各Kセル7、8のヒータ7b、8bの温度を制御すれば、in-situで各分子ビームをフィードバック制御でき、結晶の品質を向上することができる。

【0019】また、本実施例ではII族元素として亜鉛を用い、VI族元素としてセレンを用いたが、II族元素としてカドミウム(Cd)、亜鉛(Zn)、マグネシウム(Mg)のいずれか、VI族元素として硫黄(S)、セレン(Se)、テルル(Te)、マンガン

(S)、セレン (Se)、アルル (Te)、マンカン (Mn) のいずれかまたはこれらの II-VI族混晶を 用いても同様な効果が得られる。更に、本実施例では結晶成長基板として砒化ガリウム (GaAs) 基板を用いたが、ZnSeやGaP或いは砒化ガリウム (GaA

0 s)基板上に適宜な薄膜結晶(例えばエピタキシャル結

晶成長させた砒化ガリウム膜など)を形成させたもので あっても良い。

[0020]

【発明の効果】上記した説明により明らかなように、本 発明に基づく分子線エピタキシー装置によれば、II-VI族化合物半導体エピタキシャル結晶を成長させるた めに、窒素ドーパントを供給するべく、結晶成長室側に 開口すると共に窒素ガスの供給口を有する有底筒状のケ ーシングの底部に磁石が設けられ、更にケーシングの外 周に高周波コイルを配設したプラズマ励起セルからなる 10 7、8 クヌーセンセル 励起セル装置を用いることにより、低圧(10⁻⁷~10 -9 t o r r 程度)の状態であっても低い高周波パワー (5W~300W)で高いプラズマ放電発光強度が得ら れることから、容易にドーパントガス(窒素ガス)を励 起できると共にドーピングに寄与しない窒素分子ビーム 量が減り、成長面でのマイグレーションが促進され、更 に放電室内壁などからの汚染物質の発生が抑制される。 また、プラズマを発生させる際の結晶成長室内の圧力変 動が殆どないことから成長原料の分子ビームが安定す る。以上のことから従来の分子線エピタキシー装置に簡 20 14 管路 単な構造を付加するのみでII-VI族化合物半導体工 ピタキシャル結晶の品質を向上することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に基づく好適実施例に於ける分子線エピ タキシー装置の概略構成を示す模式的断面図である。

【図2】図1の励起セル装置のみの要部拡大断面図であ

【図3】ヘリコンプラズマ励起セルとrfプラズマ励起

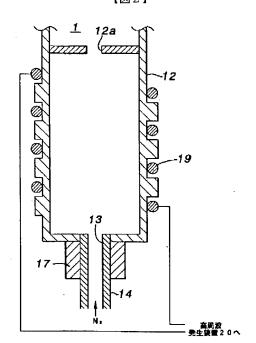
セルとで高周波パワーに対するプラズマ放電発光強度を 比較したグラフである。

【符号の説明】

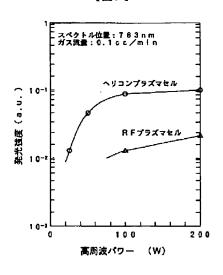
- 1 結晶成長室
- 2 超高真空排気装置
- 3 ホルダ
- 5 ヒータ
- 6 メインシャッタ
- 6a 駆動軸
- - 7a、8a るつぼ
 - 7b、8b ヒータ
 - 9、10 シャッタ
 - 9a、10a 駆動軸
 - 11 励起セル装置
 - 11a シャッタ
 - 12 ケーシング
 - 12a オリフィス

 - 13 窒素ガス供給口
 - - 15 流量制御装置
 - 16 減圧弁
 - 17 磁石
 - 18 窒素ボンベ
 - 19 高周波コイル
 - 20 高周波発生装置
 - 21 フラックスモニタ

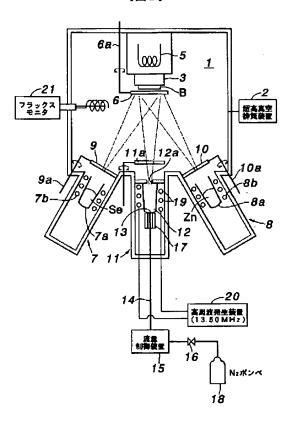
【図2】



【図3】



【図1】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁶ H O 5 H 1/46 識別記号 庁内整理番号L 9014-2G

FΙ

技術表示箇所